2024.1.21 1.重新隔离DC和USB的地 2.添加SPFM logo 2024.1.21 1.发现又有时无法启动,考虑添加ADUM1201 参考网上的串口隔离电路,除了要隔离电源,还要隔离信号。 2024.2.13 1.USB和DC使用独立的隔离模块 2.删除多余开关 3.添加贴片MCU 2024.6.4 1.之前测试时,有印象使用双隔离模块将导致发热,反复断电 2.该版本0.6没有经过验证,但是IAP版本有这样的设计, U1 12MHz VCC 发现不能同时使用USB和DC供电,只可二选一,同时使用时一定会引入DC噪音 MCLK ___ MCLK.O Tri-state VDD GND OUTPUT 3.卡槽上下两侧不要放直插运放,容易机械干涉 → MCLK 4.电源设计恢复0.55版本, DC和USB只可二选一 22p GND 12MHz 2024.9.4 1.0.8失败,此版本小心,无需增加耳放 GND 注意,有源晶振有个点 2.耳机放大器以模块的形式在音频总线以插件的形式提供。 3.删除所有退耦电容降低风险 4.增加总电源开关 已坏一个有源晶振,建议添加无源晶振 不要反复拉电源开关,这样会烧坏晶振 2025.5.28 1.删除多余组件 2.加TPA6111 U2 PIC18F2550-I/SO MCLR#/VPP/RE3 RB6/KBI2/PG0 RB5/KBI1/PGM RB4/AN11/KBIO RB3/AN9/CCP2(1)/VPC RB2/AN8/INT2/VMO RB1/AN10/INT1/SCK/SCL VCC RBO/AN12/INTO/FLTO/SDI/SDA MCLK 9 OSC1/CLKI
ICLK.O 11 OSC2/CLKO/RA6
BSEL0 12 RC0/T1OSO/T1CKI
BSEL1 13 RC2/CCP2(1)/UOE#

RC2/CCP1 MCLK.O RC7/RX/DT/SDO RC6/TX/CK RC5/D+/VP RC4/D-/VM TITLE: Sheet_1 REV: 1.0 GND GND Company: Your Company Sheet: 1/1 ♠嘉立创EDA Date: 2023-02-10 Drawn By: Denjhang

2023.12.21

- 1.已修正PCB中电位器位置不对齐模块板的问题。
- 2.已删除DC-DC稳压模块,那个会啸叫
- 3.删除二极管,保留整流管
- 4.添加大容量电解电容
- 5.修复DC口的错误接线
- 6.增加音频总线

2024.1.14

使用时发现插YM2608压降严重,请做以下修改,无需重画PCB:

- 1.删除整流管,那个将带来1V压降
- 2.L2地隔离电感,没什么用
- 3.删除BNX002,替换为IB0505S隔离稳压模块,效果完美
- 4.此时无需外置USB隔离模块
- 5.添加备用的无源晶振
- 6.精简电容
- 7.DC和USB输入共地
- 8.耳机孔位置左移
- 9.添加Logo







